

機電工程系 碩專班 108 學年度入學課程結構規劃表

課程類別			一年級						二年級					
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期		
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
專業課程	必修	應修學分數 6 學分	論文	6	6	論文	6	6	論文	6	6	論文	6	6
	選修	應修學分數 27 學分	塑膠成形技術	3	3	塑膠成形技術	3	3	塑膠成形技術	3	3	塑膠成形技術	3	3
			材料與製造	3	3	材料與製造	3	3	材料與製造	3	3	材料與製造	3	3
			統計製程管制	3	3	統計製程管制	3	3	統計製程管制	3	3	統計製程管制	3	3
			自動化與控制工程	3	3	自動化與控制工程	3	3	自動化與控制工程	3	3	自動化與控制工程	3	3
			影像處理與應用	3	3	影像處理與應用	3	3	影像處理與應用	3	3	影像處理與應用	3	3
			感測器與致動器	3	3	感測器與致動器	3	3	感測器與致動器	3	3	感測器與致動器	3	3
			智慧型系統	3	3	智慧型系統	3	3	智慧型系統	3	3	智慧型系統	3	3
			機構合成	3	3	機構合成	3	3	機構合成	3	3	機構合成	3	3
			實驗設計與品質工程	3	3	實驗設計與品質工程	3	3	實驗設計與品質工程	3	3	實驗設計與品質工程	3	3
			有限元素分析	3	3	有限元素分析	3	3	有限元素分析	3	3	有限元素分析	3	3
			超音波理論與應用	3	3	超音波理論與應用	3	3	超音波理論與應用	3	3	超音波理論與應用	3	3
			科技報告寫作	3	3	智慧自動化技術	3	3	科技報告寫作	3	3	智慧自動化技術	3	3
			智慧自動化技術	3	3	軌道車輛動力分析	3	3	智慧自動化技術	3	3	軌道車輛動力分析	3	3
			軌道車輛動力分析	3	3	科技報告寫作	3	3	軌道車輛動力分析	3	3	科技報告寫作	3	3
			機器設備智能診斷系統	3	3	機器設備智能診斷系統	3	3	機器設備智能診斷系統	3	3	機器設備智能診斷系統	3	3

備註：

一、畢業總學分數為 33 學分。

二、必修 6 學分，選修 27 學分。

三、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。

四、系所訂定條件（學程、檢定、證照、承認外系學分及其他）：

(1)每學期限修 1 門一般碩士班課程，但須於加退選前提出並經指導教授同意後送系辦備核。

(2)論文為必修(二選一)。